

グリーンイノベーション基金事業 取組状況について

提案プロジェクト名：IoTセンシングプラットフォームの構築

2025年10月30日

実施者名：ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

代表名：代表取締役社長兼CEO 指田 慎二

目次

1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略
2. 経営戦略における事業の位置付け
3. グリーンイノベーション事業の推進体制
4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取組み

目次

1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略
2. 経営戦略における事業の位置付け
3. グリーンイノベーション事業の推進体制
4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取組み

1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略

3つの事業領域の状況に応じた投資により、高い競争力の維持・強化を図り更なる成長を促進

■ SSSグループを取り巻く事業環境認識

地政学リスクや経済停滞を前提に、柔軟なサプライチェーン構築と市場多様化を進める姿勢が求められる。
同時に、AI・医療・ロボティクスなど新興領域への投資を強化し、技術差別化と顧客価値の最大化を図ることが重要。

Politics

- 世界情勢の不安定化に伴う、継続的サプライチェーン再構築の必要性
- 中国の脅威を背景とした米国の国力再強化の加速
- 内製化と内需拡大による、中国の経済的自立と影響力拡大

Economics

- 米国経済は低インフレ・中成長へ移行
- 半導体大型投資計画は見直し、成長鈍化
- 半導体企業間の製品や顧客のすみ分けが今後崩れていく可能性

Social

- 高齢化と医療・介護需要の急増が招く制度の限界とセルフケア重視への転換
- 生成AIの急速な普及と、低コストモデル登場による影響
- 小売・物流・製造・シティなど各産業における人手不足に起因するDX化への期待の高まり

Technology

- AIの進展に伴うデータセンタ向けプロセッサ技術の進展
- バイオエレクトロニクスの進展と医療ニーズの広範化による新デバイスの可能性
- ロボティクスとAIの進展により、ヒューマノイドロボット実用化の現実味

■ SSSグループ事業領域ごとの方向性

成長牽引事業、収益事業の中長期および高い競争力による更なる成長を促進。
加えて、事業拡大や収益化に一定時間を要するものの将来の成長を見込む領域へ、メリハリと規律を持った形で投資と事業運営を推進。

事業領域別の方向性



目次

1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略
2. 経営戦略における事業の位置付け
3. グリーンイノベーション事業の推進体制
4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取組み

2. 経営戦略における事業の位置づけ

サステナビリティコンパスをベースに多様なパートナーと環境課題・社会課題を解決し、持続可能な事業展開を推進

■ サステナビリティコンパス

SSSグループが「地球・社会・人」のために「ありたい姿」を定め、共感いただける様々なパートナーとサステナブルな社会に貢献していく方針として「サステナビリティコンパス」を策定

2030年を想定した
ソニーセミコンダクタソリューションズのめざす7つの社会像



ネットゼロが
実現されている社会



すべての人々が
健康で安心に
暮らしている社会



世界中の人が
いきいきと
活躍できている社会



資源を廃棄せず
リユース、リサイクル
されている社会



豊富な食糧・水が
すべての人々に
行き渡っている社会



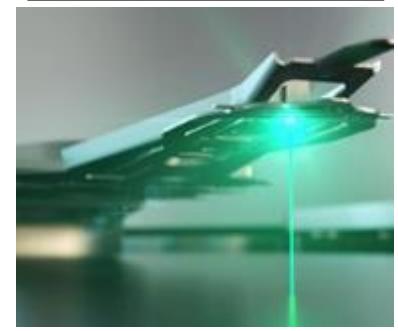
安全で効率的な
社会/交通インフラが
整っている社会



楽しさ、便利さで
人と人の心が
つながっている社会

■ 取り組み事例

HDD用半導体レーザー



HDDの記録密度を向上させることで
データセンターでのサーバーへの投資を減らし
消費電力の削減に貢献

車載事業



安心・安全な自動車への貢献だけでなく
低消費電力化技術により脱炭素化の推進

再生プラスチック事業

SORPLAS



回収されたプラスチックを再利用し
ソニーグループ内外の製品素材に
利用しサステナブルなビジネスを展開

本PJ

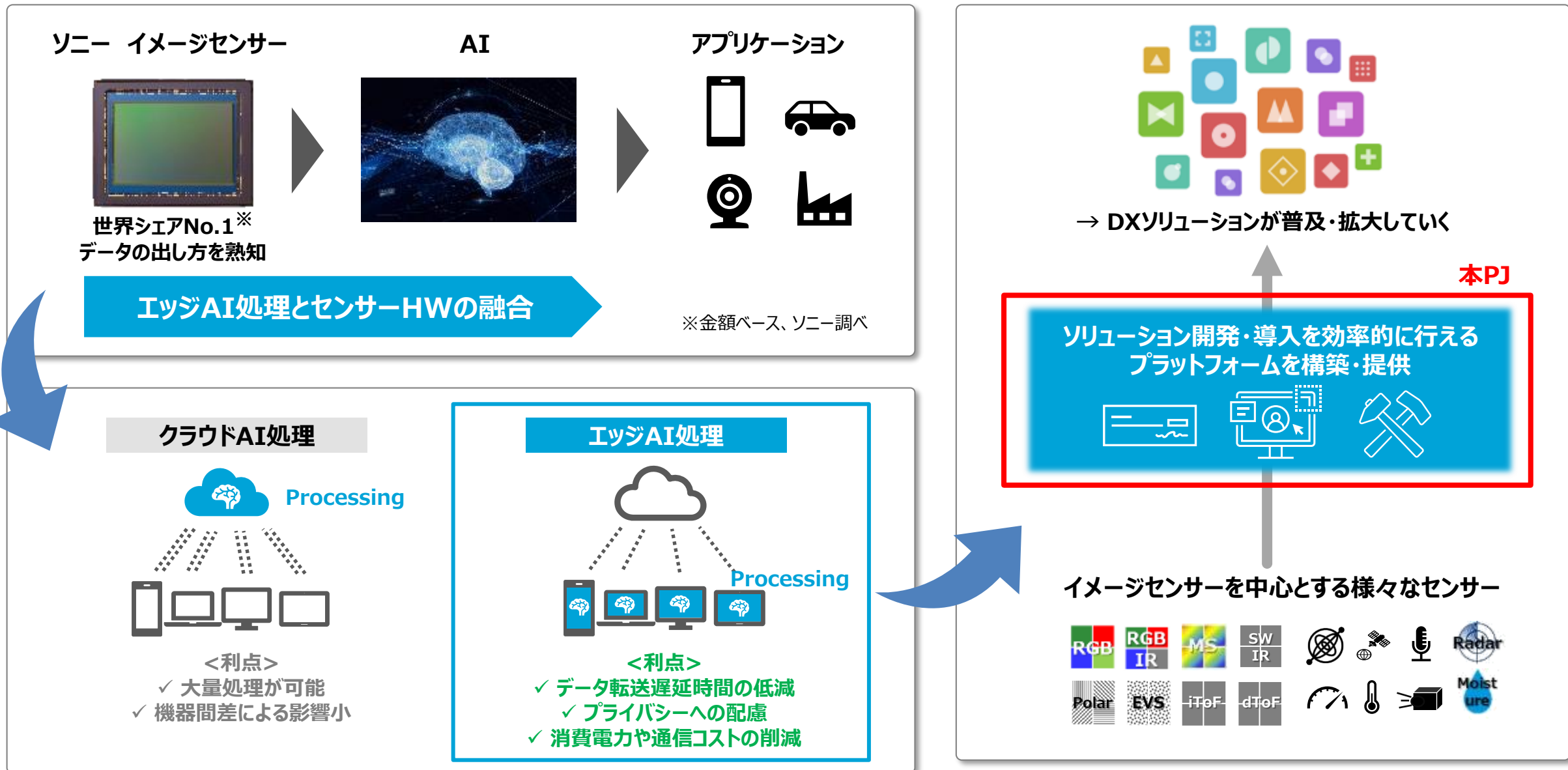
ソリューション事業



エッジビジョンAIソリューションを展開し、
データセンターでの処理低減に貢献

2. 経営戦略における事業の位置づけ

イメージセンサーで培った技術をプラットフォームとして提供することでDXソリューションの開発・普及を支援



目次

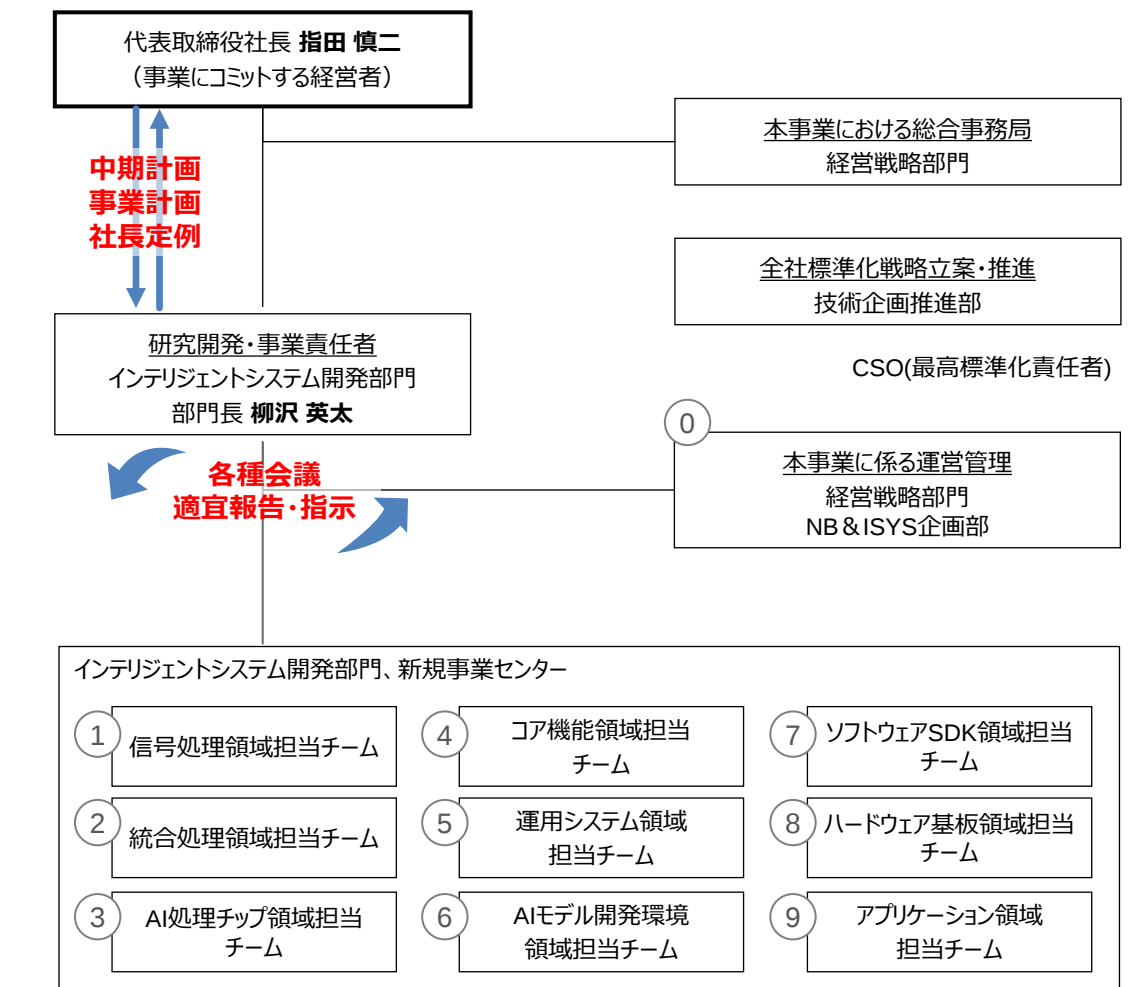
1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略
2. 経営戦略における事業の位置付け
3. グリーンイノベーション事業の推進体制
4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取組み

3. グリーンイノベーション事業の推進体制

経営層のリーダーシップのもと、グリーンイノベーション事業等に関わる戦略に基づき事業を推進

経営者自身の取組み：経営者として本事業の方向性や成果に直接的に関与しコミット。また投資家向けプレゼンテーションにて戦略的領域としてアピール
経営者としての率直な評価と今後の対応：基盤となる研究開発は順調に推移、有力顧客との案件を通じてフィードバックを得ながら、適宜研究開発内容に反映。
DX市場の立ち上がりが想定よりも遅れており、PFとして大きな成果を出すには時間が必要。市場や顧客動向を注視し、より規律を持った事業運営を実施し、既存顧客との活動は継続しつつ、有望な市場を特定し積極的なパートナー協業を推進。

組織内体制図（ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社）



組織内の役割分担

- 研究開発責任者と担当部署
- 研究開発・事業責任者
柳沢 英太：IoTセンシングプラットフォーム構築領域の事業責任者
 - 担当チーム
 - ① 事業企画部：活動全体の運営および管理（10人規模）
<研究開発1：エッジ信号処理開発>
 - ① 信号処理：低消費電力且つ高精度なエッジ信号処理技術の開発および市場化
 - ② 統合処理：複数のIoTセンサ情報の統合処理技術の開発および市場化
 - ③ AI処理チップ：AI処理を実行するロジックChipの開発および市場化
<研究開発2：SDK及びプラットフォーム開発>
 - ④ コア機能：アプリケーション開発を容易にするコア機能の開発および市場化
 - ⑤ 運用システム：アプリケーション運用を容易にする環境の開発および市場化
 - ⑥ AIモデル開発環境：AIモデル開発を容易にするAI学習環境の開発および市場化
 - ⑦ ソフトウェアSDK：DXソリューションの社会実装を容易にするSDK開発
<研究開発3：ハードウェア基板開発>
 - ⑧ ハードウェア基板：ハードウェア基板の開発とオープン化（40人規模）
<研究開発4：アプリケーション開発>
 - ⑨ アプリケーション：本プラットフォームを活用したアプリケーションの開発と社会実装（20人規模）

部門間の連携方法

- 主要開発チームは、柳沢部門長のもとで全体の活動が統制される体制とする。
- 柳沢部門長の指揮下のもとで、① NB & ISYS企画部が全体の進捗の管理を行い、関係者に対する報告や情報共有を実施する。また、各担当チームは、事業部長および①に対して、進捗等の報告を行う。
- 各チーム横断での連絡会等を実施し、部門長からダイレクトでの指示や確認が行われるようにする。
- 特許創出活動、品質管理、環境対応、セキュリティなど特定のチームに限定されない課題領域は、その担当者やエキスパートが活動全体を見据えて、各チームの所管活動に関与する。
- 最高標準化責任者（CSO）と連携し、本事業におけるオープン戦略(標準化等)、クローズ戦略を取り組む

目次

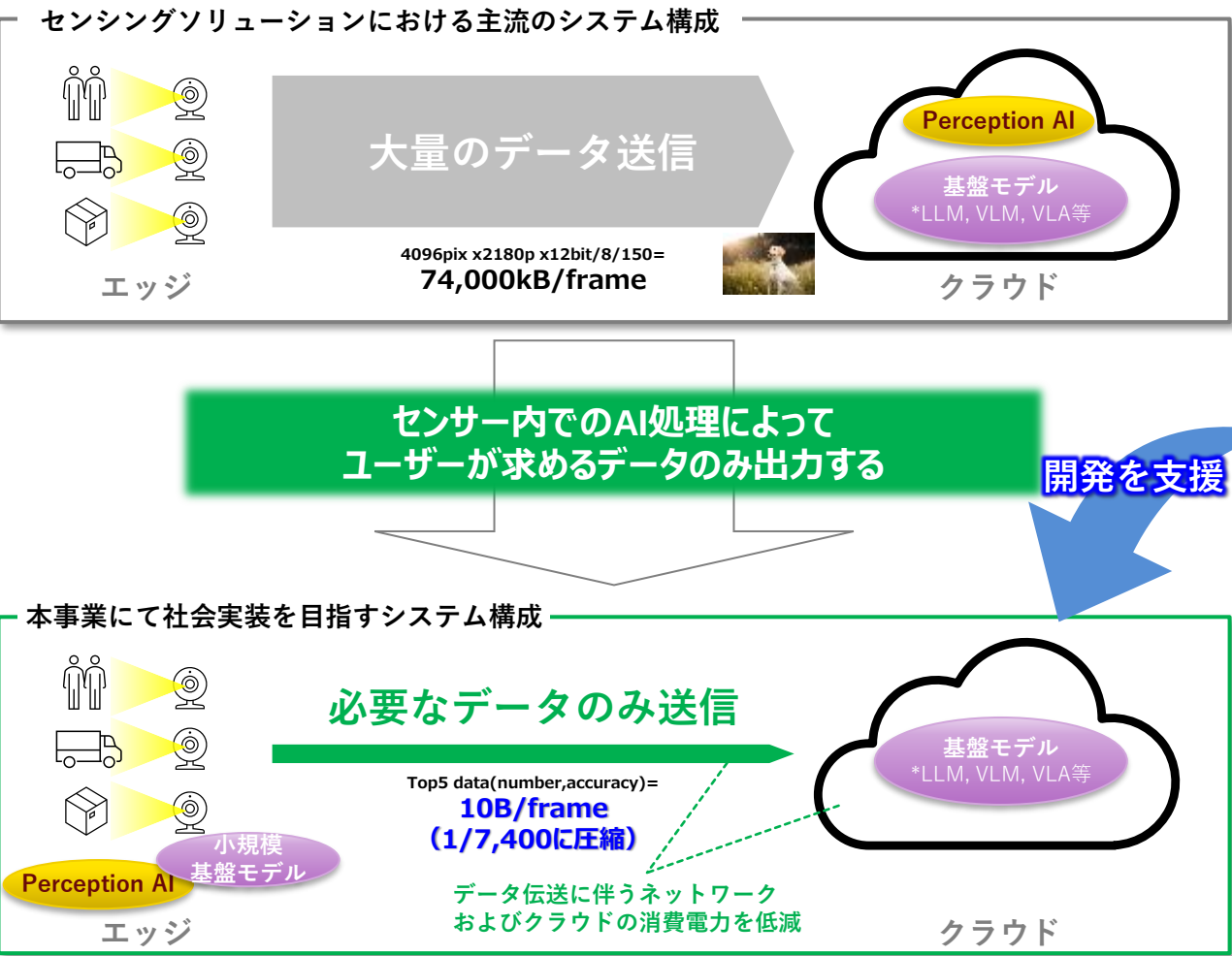
1. 経営を取り巻く環境とSSSの経営戦略
2. 経営戦略における事業の位置付け
3. グリーンイノベーション事業の推進体制
4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取組み

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

研究開発の全体概要：低消費電力のIoTセンシングソリューション構築を可能にする開発プラットフォームを構築

■研究開発を通じて目指すこと

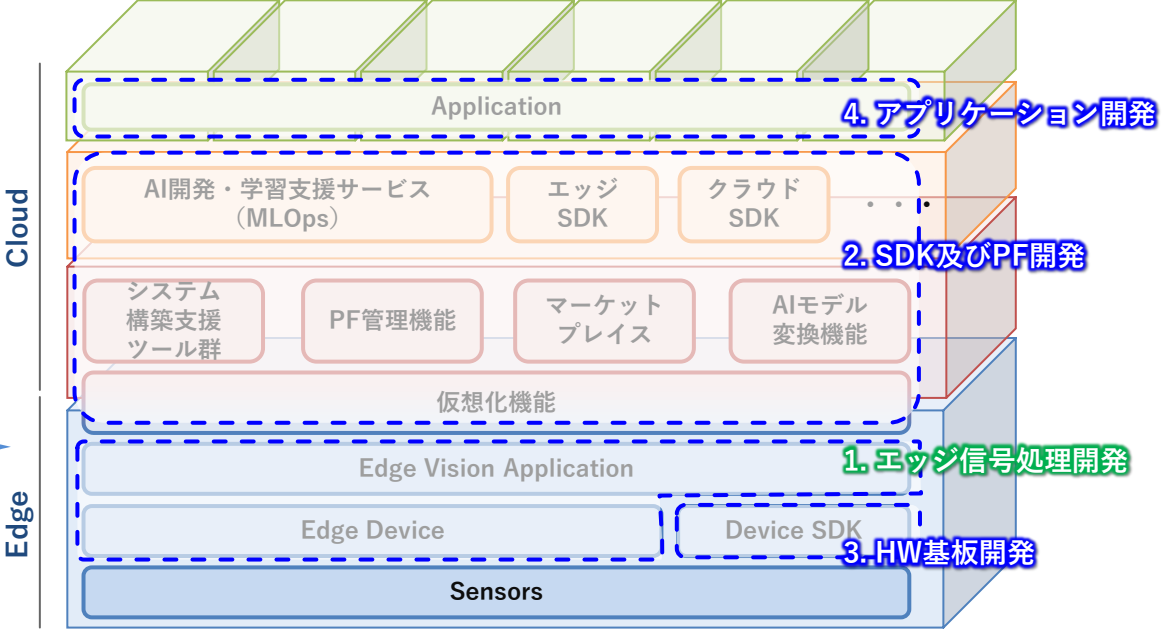
大量のデータ送信を伴うクラウド中心のシステム構成ではなく、より低消費電力化を実現するエッジ処理中心のソリューション構築を支援するプラットフォームを開発



*Perception AI：画像・音声・センサーなど多様な入力データを解析し、物体認識や環境理解を行うことを目的に、ロボット等で活用されるAI技術
*基盤モデル：大規模データを学習し、多言語翻訳や文章生成、画像理解など幅広い応用に対応する汎用的なAIの土台となる大規模学習モデル

■研究開発概要

エッジからクラウドに渡る4つの研究開発項目に沿って、ソリューションの開発・実装・運用における高い容易性を備えた開発基盤の構築に取り組む



研究開発項目	開発概要	PJ目標達成への位置づけ
1.エッジ信号処理開発	低消費電力且つ高精度なエッジAI信号処理技術開発の完了ならびに社会実装	エッジ処理により省電力・CO ₂ 削減に直接的に貢献する技術
2.SDK及びPF開発	エッジAIセンシングソリューションの開発/実装/運用を容易にできる安定的な開発基盤の構築	1の開発技術を社会に普及させるために必要な技術
3.HW基板開発	多様なユースケースに対応できるデバイスラインナップの実現につながるハードウェア基板と評価環境の公開	
4.アプリケーション開発	具体的なユースケースでユーザー課題の解決と低消費電力化を実証する	1. 2. 3. の開発技術を活用したアプリを開発し、顧客の価値検証の実施

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

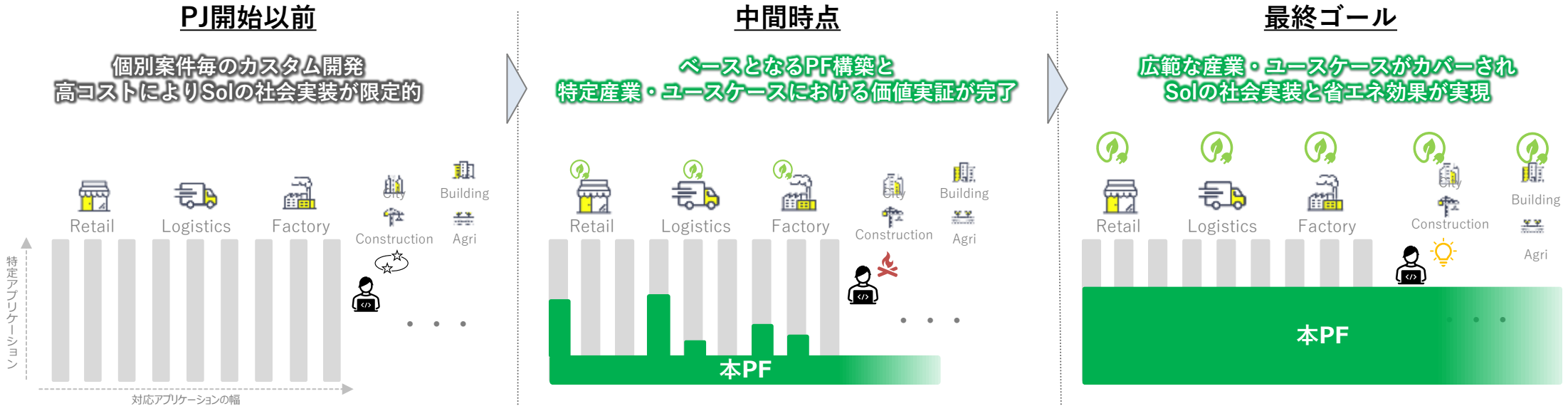
カスタマイズ開発部分

PF利用による共通化部分

研究開発の進捗イメージ：市場からのFBを踏まえて対応ユースケースと機能を段階的に拡張

本事業で構築を目指すプラットフォームは、最終的に広範な産業・ユースケース・実装環境へ対応することを通じて、省エネ効果の最大化を目指す。
市場からの要請が強いユースケースを注力対象として開発を優先的に進めて顧客価値を検証しながら、順次対応範囲と機能の拡張を段階に進める。

事業全体の進捗イメージ



研究開発項目.1 エッジ信号処理開発	処理能力が限定的となるエッジ(カメラ内)環境下で、顧客が求める精度を実現できるAIが存在しない状態。	SG1に向けた開発(詳細は次頁)	2030年に実現する姿
研究開発項目.2 SDK及びプラットフォームの開発	各案件でカスタマイズ開発が必須であり、自社で運用やメンテナンスも必要となり、価格の高いソリューションになってしまう状況	✓ RetailやLogistics等の限定したユースケースで、エッジAIの顧客要求精度を達成	✓ 低消費電力且つ高精度なエッジAI信号処理技術開発を完了し、広範なユースケースへの社会実装
研究開発項目.3 ハードウェア基板開発	既存の監視カメラやWebカメラを使用しており、エッジでのAI処理を実現できるメーが存在しない状態	✓ 基礎的なインフラ機能の構築と運用を開始 ✓ AI学習環境において、カバー可能なユースケースの拡張を目指す	✓ エッジAIセンシングソリューションの開発/実装/運用を容易にできる安定的な開発基盤の構築と運用
研究開発項目.4 アプリケーション開発	DXソリューションの先行事例が少なかったり、導入障壁が高かったりするため、顧客の導入が進まない状態	✓ 他社メーカーが参照するDevise SDKを提供し、本PFに接続可能な他社製カメラのリリース ✓ 他センサーとの接続手法調査と接続検証実施 ✓ 研究開発項目1で開発したエッジ信号処理技術を活用したアプリケーション開発を行い、顧客との価値実証を実施	✓ 多様なユースケースに対応できるデバイスラインナップの実現につながるハードウェア基板と評価環境の公開 ✓ 具体的なユースケースでユーザー課題の解決と低消費電力化を実証する(項目4は2028年度まで)

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

各研究開発項目におけるSG1マイルストーンと開発進捗状況(1/2)

今年度を予定されているステージゲート1（SG1）に向け、各研究開発項目において順調に進捗中。

研究開発項目	研究開発内容	KPI	SG1マイルストーン	進捗状況、進捗度
研究開発項目.1 エッジ信号処理開発	特に重要な差異化要素 1-① エッジ信号処理	• エッジ処理を実現するPerception AIの精度	【RGB】 センシングデバイス単独（処理能力が限定的な環境）で実行するPerception AI処理において、以下を達成する。（以下は代表例） ■モノのDX化： • LPD：Recall 95%以上 • LPR(4桁数字)：Accuracy 75%以上 ■ヒトのDX化： • 視認計測：Recall 90%以上 【特殊センサ】＜分光センシング＞ 農業用途を代表的なユースケースとして想定。 • CaseA：光源状態に依らず、分光Segmentationによる特定被写体認識のIoU（Intersection over Union） $\geq 50\%$ • CaseB：特定被写体の分光スペクトルの、真値からのずれ $\leq 10\%$ @MAPE	【RGBセンサ】 • 車番認識などの実際に社会実装を想定したユースケースで、逆光などの厳しい光源下で特に優位性を確認、直近のマイルストーン達成に向けた更なる研究開発を実行中。たとえば、LPDのRecallを91%を達成。 • 仮説が立証され、ほぼ想定通りの進捗。更に検証シナリオを増やし、広いユースケースでの実証が必要 【特殊センサ】＜分光センシング＞ • 実用的な波長センシング処理の開発において、光源推定キャンセルアルゴリズムと、セマンティックセグメンテーション性能評価技術を開発し、特定の日照条件（曇天）下で、セマンティックセグメンテーションによる植物認識が、安定動作することを確認（IoU値>50%） • 技術的には、ほぼ想定通りの進捗が得られている一方、社会実装上有用なアプリケーションの明確化について、一層の注力が必要
	1-② センサ情報統合処理	• 複数の多種センサの情報を組み合わせた場合の認識精度	測距センサにおいて、以下①～③の同時達成 ① 0.1～3mで測距精度 $\pm 3.5\text{cm}$ ② 3～20mで測距精度 $\pm 2.5\text{cm}$ ※屋内 ③ 3～10mで測距精度 $\pm 2.5\text{cm}$ ※屋外&カラー点群	• 産機市場向けニーズ仮説の立案とKey Playerヒアリングを実施。測距・波長センシングの優位性を定量検証中。検証結果をもとに有望ユースケースを整理。 物流・運搬(AGV/AMR)：SLAM 自己位置推定、障害物検知等 セキュリティゲート：Tail Gating 不正侵入、人物行動解析等 土木建築：地形測量/施工管理 • 統合処理の市場化を見据えて、有望ユースケース毎の異なる要望を明確化。
	1-③ AI向けLogic Chip開発	• AI向けLogic Chipの開発進捗		

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

各研究開発項目におけるSG1マイルストーンと開発進捗状況(2/2)

今年度を予定されているステージゲート1（SG1）に向け、各研究開発項目において順調に進捗中。

研究開発項目	研究開発内容	KPI	SG1マイルストーン	進捗状況、進捗度
研究開発項目.2 SDK及びプラットフォームの開発	2-④ PFコア機能	- 制御可能デバイス数 - UI応答速度	- 制御台数制限なし、オートスケール - クラウドサービスのUIの答速度：1.2s以内	1つのクラウドサービスから制御できるデバイス数：3,000台 - クラウドサービスのUIの答速度：3s以内
	2-⑤ PF運用環境	- PF全体の安定稼働率 - サービス監視等の稼働率	- 全ての商用サービスを含めて稼働率99% - サービス監視とアラートハンドリング機能の稼働率98%	- AIサービスにおいてPoC段階で99%未達 - サービス監視とアラートハンドリング機能について、Onboard中新サービス含め70%を達成
	特に重要な差異化要素 2-⑥ AI開発・学習環境	- テンプレートモデルのラインナップ数 - MLOpsツールの開発・性能・実装状況	- 学習が可能な環境のAzure上での立ち上げ - 視認検知用、ナンバープレート自動認識用のTemplate modelの開発完了 - アノテーション不要な学習環境の実現	- 特定ユースケース（ライセンスプレート認識）の画像認識AI学習技術の基礎検討完了し、Azure環境に実装完了 - 物理モデリング技術及びCGによって拡張したデータセットで学習した結果のフィードバックを受けて拡張機能改善を実施中 - 画質特性改善について模擬実験環境を活用し評価を実施。アルゴリズム改善の実施中
	2-⑦ Edge/Cloud SDK	- ユーザーのApp開発時間 - Edge Appの推論稼働率	- アプリケーション開発時間 12hours以内 - 推論稼働率 99%	- 現状は平均72hoursの状況。アプリケーション開発時間を短縮するために必要となる開発ツール群を導入開始し、更なる時間が短縮へ向けた取り組みを実施中 - エッジアプリ安定稼働を実現するためのCI/CD環境を構築
研究開発項目.3 ハードウェア基板開発	3-⑧ HW基板	- HW基板を用いた他社製カメラのリリース数 - RGB以外センサ評価環境の構築状況	- 他社製のカメラが2社以上からリリース - 特殊センサの評価環境が利用可能な状態 - その他IoTセンサの環境を準備	- 様々な社会実装に適用させるため OS、CPUデバイスに依存しないソフトウェアアーキテクチャを開発。 - 他センサとしてマイク活用に向けたHW基礎特性評価完了
研究開発項目.4 アプリケーション開発	4-⑨ アプリケーション開発	App全体での精度	■モノのDX化： - LPD：Precision 95%以上 / Recall 95%以上 - LPRはAccuracyで90%以上 ■ヒトのDX化： - 視認計測：Precision 75%以上	- 物流とリテールに注力してデータ解析用のアプリケーションの開発を実施。たとえば、物流のLPRはAccuracyで82.1%を実現。 - 同時に画像認識AIの性能向上により実現性可能性向上の取り組みを実施中。モデルサイズの最適化により、AI（YOLOX-Tiny）で認識できる画像サイズの拡張が可能となった

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

研究開発進捗事例：エッジ信号処理ならびにAI開発・学習環境

エッジAI処理による低消費電力化技術を活用したDXソリューションの社会実装を目指し、研究開発を実施中。社会実装加速に向け、顧客要求を満たすエッジAIの高精度化や、パートナーが容易に使えるPFの構築が肝要。

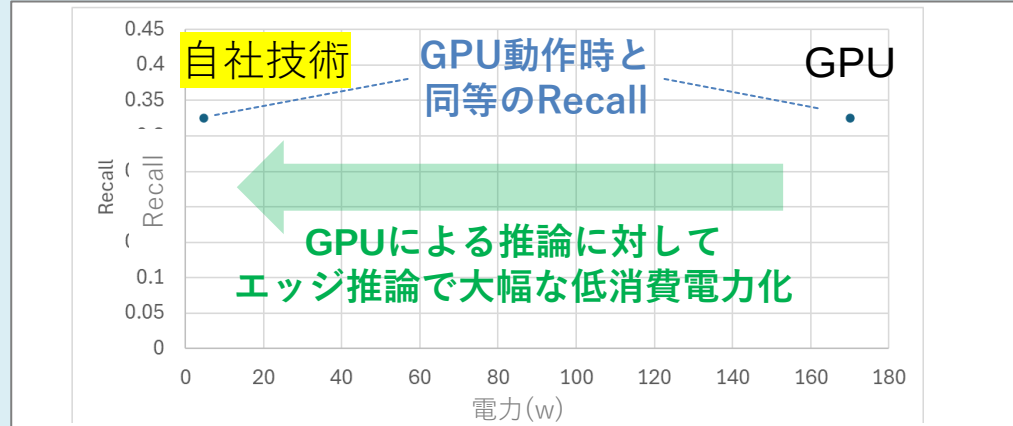
研究開発項目.1	研究開発内容	KPI
エッジ信号処理開発	1-① エッジ信号処理	・エッジ処理を実現するPerception AIの精度

GPU処理に比べ低消費電力化を実現、
且つ同等のAI処理性能を確認

$$\text{Recall} = \frac{\text{正解検出数}}{(\text{正解検出数} + \text{未検出数})}$$

【検証結果】

- 縦軸：精度(Recall)、横軸：計測できた消費電力



【検証概要】
物体検出のAIモデルを以下の2種類のデバイスで実行した際の電力および精度(参考情報)をそれぞれ計測する。
※共通のマウス、キーボード、モニターを接続
① GPU PC - CPU : Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz
- GPU : NVIDIA GeForce RTX2080 Ti
② Raspberry Pi AI Camera (センサー内でのエッジAI処理、本事業のスコープ)
- Raspberry Pi 5に接続して使用

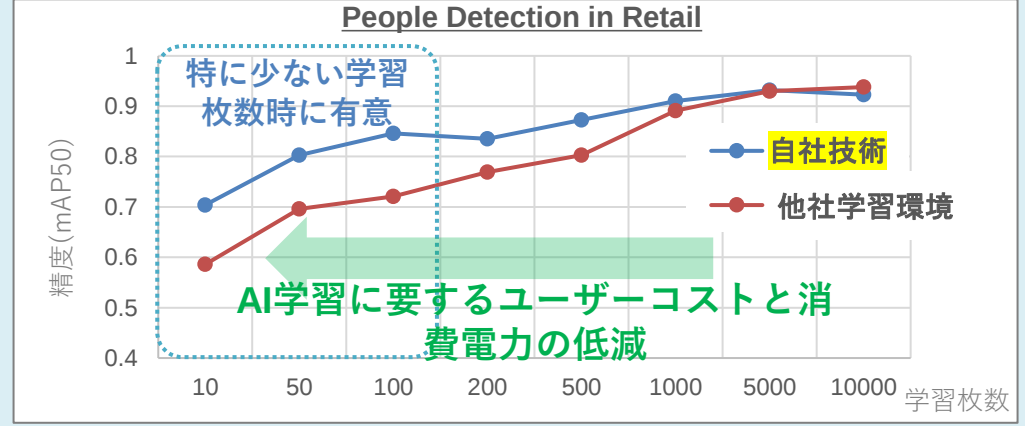
研究開発項目.2	研究開発内容	KPI
SDK及びプラットフォームの開発	2-⑥ AI開発・学習環境	・テンプレートモデルのラインナップ数 ・MLOpsツール開発・性能・実装状況

ユーザー負荷軽減および低消費電力化の観点から、
省枚数学習時での高精度実現に向けた研究開発を実施

* IoUが0.50以上で正解とみなす前提での
平均精度 (AP) の平均値

【検証結果】

- 縦軸：精度 (mAP50*)、横軸：学習枚数



【検証概要】
・ AIモデルの再学習機能における、学習枚数毎での精度についてベンチマーク検証
【検証方法】
・ ユースケースとして、小売店舗における人検知で検証
・ 精度指標は物体検出 (Object Detection) タスクにおける精度の指標のひとつであるmAP50*を使用
精度評価用画像としてそれぞれ450枚を使用

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

研究開発項進捗事例：センサーメーカー協業進捗

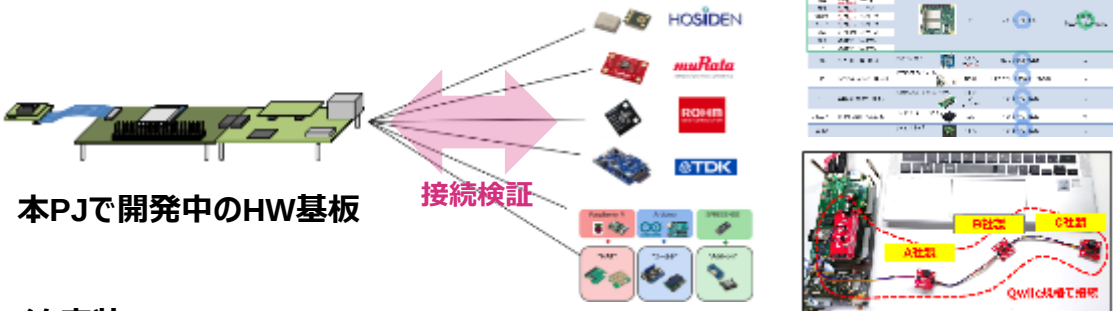
研究開発項目3にてイメージセンサー以外の他社製IoTセンサとの接続検証やデバイスへの実装検証を実施中。
各種IoTセンサーとオープンに連携できる形にハードウェア基板を進化させ、対応ユースケースの多様化を目指す。

～2025年

各社センサーとの接続検証を通じた開発環境構築を推進中。
また先行検討としてマイクセンサを既存HWシステムに搭載する検証を実施中。

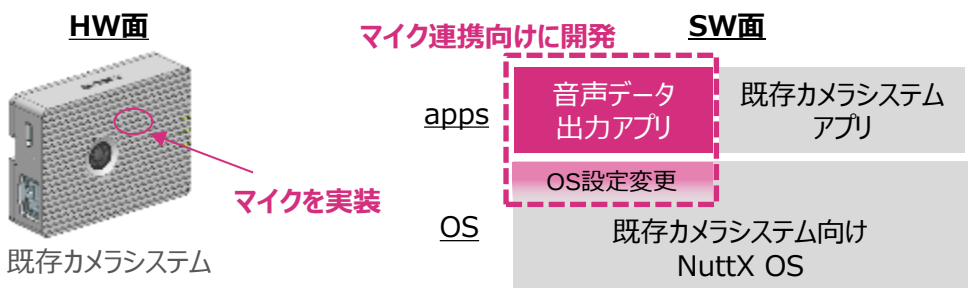
①国内各種センサー開発環境

RGBセンサ以外のセンサーと、自社リファレンス開発環境との
接続手法の調査実施及び各種実機での接続検証開始。



②マイク実装

新規設計カメラシステム上にマイクの実装を行い、現在マイク音声取得まで完了。
今後、データの活用を検討していく。



～2028年

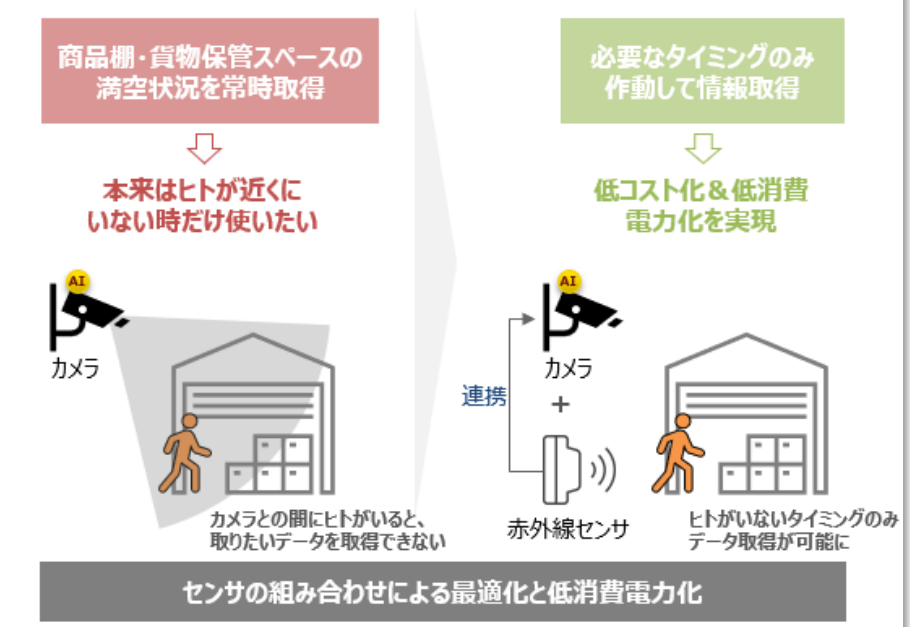
他社センサーとの連携した開発環境
の構築とPoCを通じてVoC収集を
進める。

最終ゴール

他社センサーと連携したデバイスなら
びにアプリケーションの社会実装を本
格化。

■センサー連携によるアプリケーション想定例（事業戦略ビジョンより抜粋）

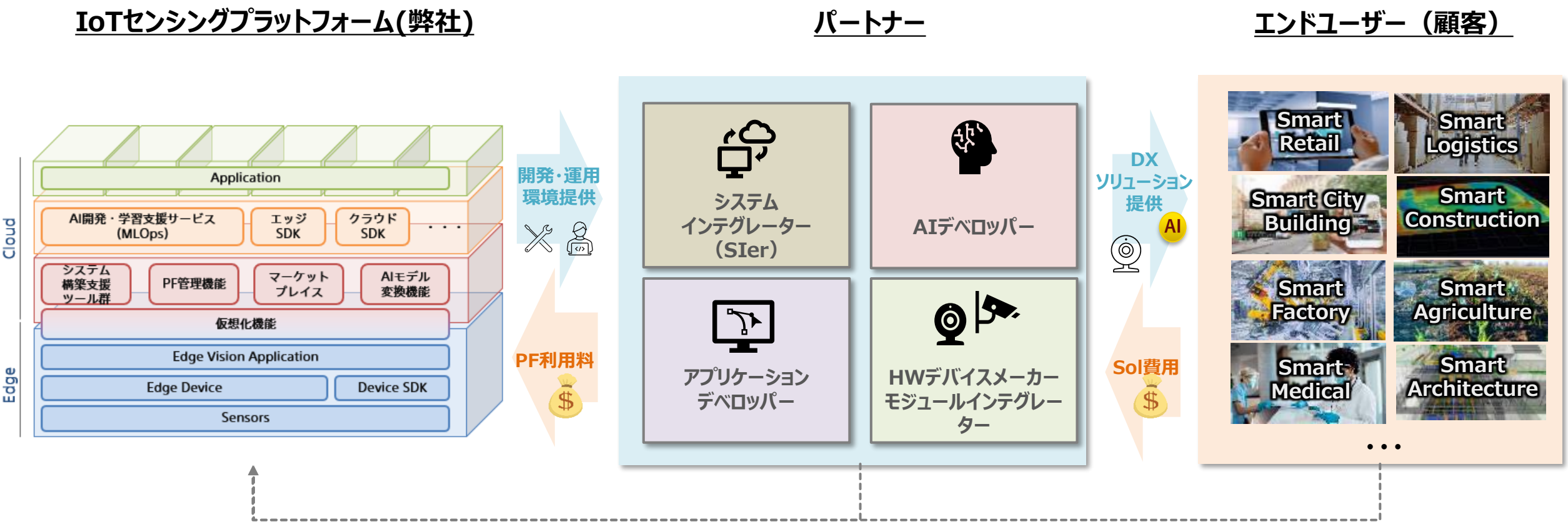
小売分野・物流分野における空き棚スペース検知の事例



4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

ビジネスモデルの概要：弊社提供の開発PFを様々なパートナーが利用し、ソリューションを開発、エンド顧客へ提供する

- ・パートナーはPFを利用し、低コスト且つ短いリードタイムでソリューション開発を行い、エンドユーザにソリューションを提供
- ・弊社はパートナー企業からサブスクリプション方式にてPF利用料を徴収

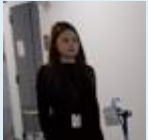


■ 技術の着実な社会実装に向けて
短サイクルでの実証実験の計画・実施や顧客とのハンズオンラボ運営を通じて現場での検証・評価を実施。
実際の想定顧客やパートナーから直接フィードバックを収集し、開発活動の改善に活用する取り組みを推進中。併せてPFのコア機能にあたるSWやツール、HW開発環境をオープン化することで顧客やパートナーの導入障壁を低減する取り組みも実施。

4. 研究開発の進捗及び社会実装に向けた取り組み

注力する産業・ユースケースを設定し、エンド顧客/パートナーとの協議&ヒアリングを通じてニーズを確認しながら事業化に向けた活動を展開中

社会実装加速に向けてキーとなるプレイヤー

産業	ユースケース概要	産業毎サプライチェーンと社会実装に向けた取り組み				
Retail	【視認検知】 ・店舗に設置したデジタルサイネージの顧客視認分析(視認人数や視認率) 	Sony AI developer ② Application developer ③ Solution Developer, Installer 設置工事 メンテナンス ① エンドユーザー HWメーカー	・①多店舗展開している大手企業にフォーカスし攻略。②サイネージ市場におけるキープレイヤーであるCMSベンダー、③リテール業界を得意とするSierと協業体制を築き拡販。ソニーGpのチャネルも活用 *CMS：コンテンツマネジメントシステムの略			
Logistics	【車番検知】 ・トラックの車番認識とバス予約ソリューションとの連携 	Sony AI developer ① Application developer Solution Developer, Installer 設置工事 メンテナンス エンドユーザー HWメーカー	・①SaaS提供企業等の物流Pferと協業し、大手物流不動産企業へアプローチ。サービス導入・テナント企業への拡販を狙う			
Factory	【画像検査・設備組み込み】 ・画像検査機能の生産ラインや設備への組み込みによる物体検出・異常検知 	Sony ① AI developer Application developer Solution Developer, Installer 設置工事 メンテナンス エンドユーザー HWメーカー	・①FA分野における有力企業と協業体制を構築。AIとカメラ一体型のソリューションを開発し、効率的な拡販を実現する *PLC：PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)の略			
City (車番検知)	【車番検知】 ・駐車場管理システムとの連携による車室満空検知 	Sony AI developer ① Application developer Solution Developer, Installer 設置工事 メンテナンス エンドユーザー HWメーカー	・①国内コインパーキング向けにシェア多数を占める大手企業と協業し市場で進むスマートパーキング需要の獲得を目指す			
City (顔認証)	【顔認証】 ・エッジ処理を活用した安価・高機能の顔認証システム(特徴量抽出) 	Sony ① AI developer Application developer Solution Developer, Installer 設置工事 メンテナンス エンドユーザー HWメーカー	・①同分野で先進企業との協業を通じ精度の高いアプリケーションを市場に提供。同社の持つ幅広いマーケットへのリーチも実現する			

前回WG（令和7年4/8）でのご指摘・ご意見（対応一覧表）

No	ご指摘事項	回答
1	事業戦略のさらなる具体化等を急ぐ必要がある。特に、ビジネス面や知的財産において、複数シナリオをもって複数戦略を検討することが重要。	本PJでは、DXニーズの高い産業（小売・物流・シティ・ファクトリー）に特化し、業界のキープレイヤーと連携して大手顧客を重点開拓しています。プラットフォーム開発ではアジャイル手法を採用し、短サイクルでリリースと実証実験を繰り返し、顧客からのフィードバックを開発に反映することで、常に具体的なニーズを把握し必要によりシナリオを軌道修正できるように努めております。知財面では、オープンコア戦略をとっております。PFのコア機能を積極的にOSS化・無償提供し普及を促進するとともに、競争優位性のあるエッジAI領域で収益化を図っています。事業環境や顧客ニーズの変化に応じて柔軟に最適化し、社会実装と事業成長を同時に推進してまいります。
2	既存の顧客ニーズ把握については一定程度なされているが、今後の大きな外部環境の変化に対応するため、既存顧客以外のニーズを把握するとともに、変化を迅速に察知し、対応できるよう努める必要がある。	本PJでは、DX化スピードが速い外部環境に対応するため、既存顧客に加え、新規顧客のニーズ把握を重視しています。各業界に精通したパートナーと連携し、業界特有の課題やDXニーズを的確に把握・開拓しています。また、生成AIやエージェントAIなど既存技術の代替となりうる関連技術の動向を継続的にウォッチし、外部環境や市場の変化を迅速に察知できる体制を整えています。これにより、顧客ニーズの変化や市場環境の変化に柔軟に対応し、PJの技術導入と価値創出を加速させています。
3	供給能力や性能・信頼性を示すことで、自らの技術を認められ、受注拡大・シェア獲得に至る可能性が高まるため、社会実装を加速する上で能動的なマーケティングにも取り組む必要がある。	本PJでは、早期からマーケティングにも力を入れて取り組んでいます。エンド顧客に対してハイタッチの営業活動を行い、事業開発を早期から実施し、弊社の差別化要素であるイメージセンサ技術とエッジAIの独自ポジションを明確に伝えています。また、プラットフォームの信頼性やスケーラビリティを含めた技術的優位性を示すことで、顧客に価値を認めてもらい、受注拡大やシェア獲得を図ってまいります。具体的には、直接営業、展示会出展、プレスリリースなど多様な手段で積極的に情報発信などのマーケティング活動を推進してまいります。
4	各社とも、事業戦略における応用分野が総花的であり、技術戦略との関係性が不明瞭。分野ごとに求められるスペックが異なり、それに応じて技術戦略も変わるため、事業戦略と技術戦略を一体的に考えて検討を深める必要がある。	ご指摘の点について非常に重要と認識しております。現状、小売業向けにはサイネージ・棚検知や在庫管理、物流業向けにはトラックバース管理や入出荷モニタリング、スマートシティ・工場向けには監視・自動化を中心にターゲットを置き、業界のキープレイヤーと協業しながら市場ニーズを把握しています。それぞれの応用分野に求められる精度、処理速度、耐環境性などの性能要件に応じ、エッジAI精度やセンサー性能、プラットフォームのスケーラビリティ設計を最適化することで、事業戦略と技術戦略を連動させ、社会実装の加速と競争優位性の確立を同時に推進してまいります。
5	標準化戦略の策定・実践は、事業戦略と技術戦略の統合のための有効な手段。経営層が主導して、標準化戦略を検討する体制を早急に整備する必要がある。	本事業で目指しております開発PFの構築においては標準化戦略の策定・実践に取り組んでおります。特にPFを構成する技術要素をオープンソース化し、広く公開することで業界におけるデファクトスタンダードを確立することが肝要と考えております。そのためにOSPO（Open-Source Program Office）を設立して専門体制を整備しています。OSPOでは事業・技術戦略に基づいたPFの普及促進活動を行い外部OSS開発者（コントリビューター）の巻き込み活動や社内OSS人材の育成などに力を入れています。
6	国内の労働人口の減少という課題があり、また人材の流動性が増している中、半導体やデータセンターは重要な産業分野であり、戦略的に人材確保や人材育成を進めていく必要がある。	弊社はご指摘の業界課題に対して様々な活動を通して積極的に取り組んでいます。一例として学生向けには、熊本・崇城大学でのDX人材育成プログラム（ https://www.sony-semicon.com/ja/feature/2023072801.html ）や、奈良女子大学での「センサ工学」講座（ https://www.sony-semicon.com/ja/feature/2023092901.html ）を通じた専門教育を実施しています。また、2023年より九州半導体人材育成等コンソーシアムに参画し、業界横断的な人材育成・交流を推進しています。これにより、中長期を見据えて半導体分野の戦略的成長に貢献できる人材基盤の整備を進めています。

SONY

SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。

各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。